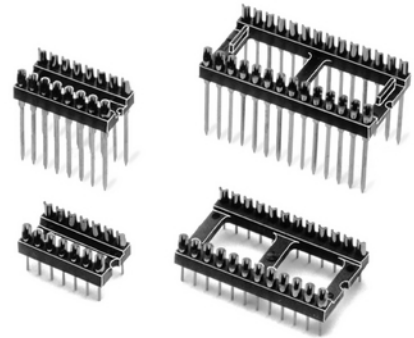
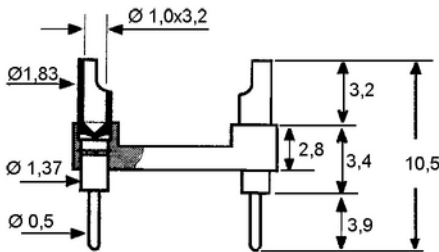


Technische Daten / Technical Data

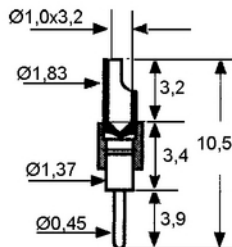
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ <i>< 10mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{RMS} <i>1kV_{RMS}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{RMS} / 150V _{DC} <i>100V_{RMS} / 150V_{DC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C <i>-55°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



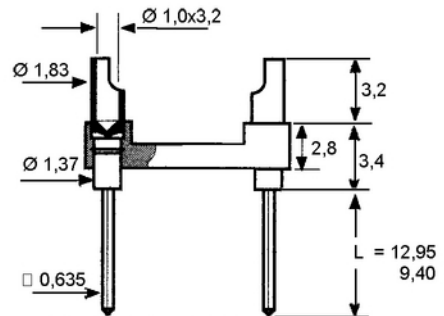
© W+P PRODUCTS



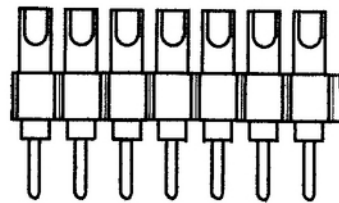
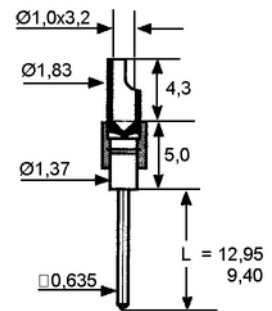
Einlötlanschluß
Solder Type



IC-Fassung Serie 176
IC-Socket Series 176



Wire-Wrap Anschluß
Wire-Wrap Type



IC-Leiste Serie 189
IC-Strip Series 189

Series	Contacts*	DIP*	Terminals*	Plating*
176	24	4	10	10
176 IC-Fassungen <i>IC Sockets</i>	06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 28 20 22 24 28 32 10 24 28 32 36 40 42 48 50 52 50 52 64	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=3,90, Ø0,50mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm <i>10µ" gold plated clip</i> 30 Feder vergoldet 0,75µm <i>30µ" gold plated clip</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i>
Series	Contacts*	Rows*	Terminals*	Plating*
189	16	2	10	10
189 IC-Leisten <i>IC Headers</i>	01-64 Einreihig <i>Single row</i> 02-64 Zweireihig <i>Double row</i>	1 Einreihig <i>Single row</i> 2 Zweireihig <i>Double row</i>	10 L=6,60, Ø0,50mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm <i>10µ" gold plated clip</i> 30 Feder vergoldet 0,75µm <i>30µ" gold plated clip</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Löttempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

